# Chapter 11

## Halbleiter

#### Charakteristika:

- Metallischen Glanz aber kein Metall
- Negativer Temperatur Koeffizient  $\rho \uparrow T \downarrow$
- Photoleitfähigkeit
- Eigenschaften können von Verunreinigungen empfindlich abhängen

Materialien: 4.hauptgruppe: Si,Se, Ga,Teller, P, B, Verbindungen III-V: GaAs, InSb II-VI: ZnS,CdS IV-IV: SiC Elektrischer Widerstand

Metall  $\rho=10^{-7}$  bis  $10^{-8}\Omega m$  isolator  $\rho>10^{12}\Omega m$  Halbleiter  $\rho=10^{-4}$  bis  $10^{7}\Omega m$   $\exists$  Bandlücke, kleiner als bei Isolatoren bei T=0 Halbleiter sind Isolatoren T¿0 Wahrscheinlichkeit für eine Termische Anregung  $E_g>0,1...2eV$   $E\propto e^{-\frac{E_g}{2kT}}$ 

<u>Intrinsische Halbleiter</u>: Eigenschaften werden durch Thermische anregung bestimmt <u>Extrinsische Halbleiter</u>: Eigenschaften werden durch Dotierung von Frembatomen bestimmt

- 1) Intrinsische HL
  - a) Bandlücke und optische Abstände Indirekter Übergang Impuls wird durch Phonon gewährleistet;

    Kristallimpulserhaltung Übergang hängt von Phononenspektrum ab und daher von der Temperatur abhängig. Photon: große Energie, kleiner Impuls; Phonon: kleine Energie, großer Impuls

Direkter Übergang

schwache Temperaturabhängigkeit (vgl  $1500nm \approx 0, 8eV$ 

b) Effektive Massen von Elektronen und Löchern

Bandkrümmung in der Nähe des Übergangs,; Parabolische Näherung:

$$E_n = E_L + \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*}$$

mit n=Elektronen und p=Löcher. Elektronen im Leitungsband im

$$\begin{array}{ll} & \text{Transversal} & \text{Longitudinal} \\ \text{Si} & \frac{m_t^*}{m_e} = 0, 19 & \frac{m_l^*}{m_e} = 0, 19 \\ \text{Ge} & \frac{m_t^*}{m_e} = 0, 082 & \frac{m_l^*}{m_e} = 1, 57 \end{array}$$

Löcher im Valenzband Si  $\begin{array}{ccc} & \text{Transversal} & \text{Longitudinal} \\ 0,16mc & 0,49mc \\ \text{leicht Loch} & \text{schweres Loch} \end{array}$ 

$$GaAs \begin{tabular}{lll} $\operatorname{GaAs}$ & L\"{o}cher & $\frac{m_t^*}{m_e}=0,12$ & $\frac{m_t^*}{m_e}=0,61$ \\ & & \text{leicht} & \text{schwer} \\ & & \text{leicht Loch} & \text{schweres Loch} \\ \end{tabular}$$

c) Metall-Halbleiter Übergang

Austrittsarbeit  $\phi$  zum Vakuum. Die Austrittsarbeit bestimmti die el. Eigenschaft.

n-Dotiert:  $\phi_{HL} > \phi_{ME}$  ohmscher Kontakt  $\phi_{HL} < \phi_{ME}$  blokierender Kontakt (Schottky-Kontakt). An der Grenzfläche ensteht eine Hochohmige Verarmungszohne. Elektronen fließen ins Metall

p-Dotiert: genau andersherum

## 2) Dotierte HL

- a) Spezifischer Widerstandhängtstart von der Konzentration der Verunreinigung ab.
- b) Donatoren: liefern zusätzliche Elektronen ins Leitungsband: P, As, Sb; haben eine höhere Valenz Akzeptoren: liefern zustzliche Löcher in Valenzband. niedrigere Valenz als das Wirtsmaterial: B,Al,Ga,In

Modell: Donator verhält sich wie ein positiv geladenes Ion mit zusätzlichen Elektron. Bohr-Radius somit größer als beim H-Atom; Bindungsenergie  $\approx 10 meV$ 

## 3) Inhomogene HL

- a) p-n Übergang
  - angleichung des chem. Potentials  $(E_F)$
  - Verarmung freier Ladungsträger im Bereich des Übergangs durch rekombination mit Ladungsträgern von anderen Typ.
  - geladenen Störstellen bleiben zurück, es entwickelt sich eine Raumladungszone
- b) Schottky-Motell

Kastenförmiger Verlauf der Raumladungs-Zone; V(x) =Potentialverlauf, in y,z  $\infty$  ausgedehnt Poisson Gl:

$$\Delta V(x) = \frac{-\rho(x)}{\epsilon_0}$$

selbstkonsistenzproblem:  $\rho(x)$  hängt von V(x) und umgekehrt ab. Itaratir  $\rho(x) \to V(x) \to \rho(x)$  Dicke der Raumladungszone  $eV_D \simeq E_g \approx 1 eV, n = 10^{10}$  bis  $10^{24}; d = 1 \mu m$  bis 10 nm; vergl. Atom-Atom  $\epsilon \approx 10^{10} \frac{V}{m}$ 

c) Ströme in Gleichgewicht

Diffusionsstrom. El aus dem n-HL rekombinieren mit Löchern p-HL  $\Rightarrow$  Ladungs Feldstrom: Elektronen aus dem p-HL (Minoritätsladungsträder) werden durch das E-Feild in n-HL Im Gleichgewicht heben sie sich auf.

Ph Übergang unter Spannung

- $E_F + eU$  muss ausgeglichen sein
- Durchlassrichtung U rec die Potentialdifferenz
- Sperrichtung Pot-Diff vergrößert
- Diode Durchlassrichtung große lLeitfähigkeit; Sperrichtung kleine Leitfähigkeit